

Informazione Regolamentata n. 2358-13-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 10 Marzo 2026 06:43:20	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : SECO

Utenza - referente : SECON04 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 10 Marzo 2026 06:43:20

Data/Ora Inizio Diffusione : 10 Marzo 2026 06:43:20

Oggetto : SECO presenta la propria strategia di
piattaforma completa per l'Edge AI a embedded
world 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

SECO presenta la propria strategia di piattaforma completa per l'Edge AI a embedded world 2026

Arezzo, 10 marzo 2026 – SECO S.p.A. ("SECO" o la "Società"), fornitore leader di soluzioni di edge computing e per la digitalizzazione AI-driven, presenta a embedded world 2026, al via oggi a Norimberga (Germania), il proprio portafoglio tecnologico a oggi più completo.

La Società mostrerà nuove piattaforme hardware, funzionalità software e dimostrazioni dal vivo che evidenziano il ruolo di SECO quale partner strategico nell'abilitare la transizione industriale verso prodotti intelligenti, connessi e orientati ai servizi. L'offerta ampliata riflette la continua crescita di SECO nei mercati industriale, medicale, vending, trasporti e smart infrastructure.

Le principali novità includono:

- **Collaborazione con Qualcomm** – Lancio di nuove soluzioni basate su Dragonwing, tra cui il SOM-COMe-CT6-Dragonwing-IQ-X e le future piattaforme SMARC e COM-HPC. Questi sistemi offrono elevate prestazioni, AI in tempo reale e indipendente dal cloud per applicazioni di automazione, computer vision e robotica in ambienti industriali complessi;
- **Partnership con Intel** – Introduzione di piattaforme basate su processori Intel Core Ultra Series 3 e Intel Atom, guidate dal SOM-COMe-BT6-PTL. Una demo live sviluppata con Reply dimostra casi di automazione software-defined e intelligenza edge-native, evidenziando la capacità di SECO di modernizzare asset industriali legacy;
- **Espansione dell'ecosistema NXP** – Debutto di Modular Vision 10.1 MX95 e SOM-SMARC-MX95, piattaforme HMI ed embedded sicure e scalabili basate sui nuovi processori i.MX 95. Le soluzioni integrano funzionalità di functional safety, caratteristiche avanzate di cybersecurity e supporto a lungo termine del ciclo di vita per applicazioni mission-critical;
- **Portafoglio Edge AI MediaTek** – Presentazione dei nuovi SOM-Trizeps-X-Genio360 e Modular Vision Genio700 HMI. Queste piattaforme rispondono alla crescente domanda di Edge AI a costo contenuto, HMI avanzate e inferenza on-device in ambito medicale, industriale e mobile, ampliando il mercato indirizzabile da SECO;
- **Software framework Clea** – Dimostrazione di Clea quale layer software unificato per l'AI-IoT di SECO, in grado di abilitare gestione sicura delle flotte di dispositivi, aggiornamenti OTA (over-the-air), orchestrazione dei dati e deployment scalabile di applicazioni AI containerizzate. Le demo live – tra cui MUSAI e diverse esperienze HMI – evidenziano la capacità di Clea di trasformare i dispositivi edge in asset digitali pronti per l'erogazione di servizi;
- **Offerta SECO per la Cybersecurity** – SECO propone inoltre il proprio framework di cybersecurity per la protezione dei dispositivi connessi lungo l'intero ciclo di vita. L'offerta comprende gestione delle vulnerabilità, aggiornamenti software sicuri, monitoraggio dei dispositivi e supporto alla conformità normativa, consentendo agli OEM di implementare e gestire prodotti connessi resilienti in linea con le normative emergenti, tra cui il Cyber Resilience Act;
- **Smart Vending & Payments** – Presentazione di una soluzione vending pronta all'uso che integra Clea Vend e il terminale di pagamento contactless Karl4. Dopo una forte penetrazione a livello nazionale in Germania,



COMUNICATO STAMPA

la piattaforma è ora in fase di espansione in Italia e negli Stati Uniti, dimostrando la capacità di SECO di integrare hardware embedded, analytics cloud e servizi digitali a ricavi ricorrenti.

Nel complesso, le innovazioni presentate evidenziano la strategia integrata per l'Edge AI di SECO, che combina hardware avanzato, il framework software AI e IoT Clea e le capacità di abilitazione per le applicazioni attraverso il SECO Application Hub in un ecosistema scalabile end-to-end.

*"Quest'anno a embedded world, SECO dimostra la profondità e la maturità di una strategia di piattaforma completa dall'Edge all'AI," ha dichiarato **Massimo Mauri, CEO di SECO**. "Attraverso una stretta collaborazione con i nostri partner tecnologici e l'adozione crescente di Clea, supportiamo i clienti nella trasformazione dei loro prodotti in soluzioni intelligenti, connesse e abilitate ai servizi."*

I visitatori possono scoprire l'intera offerta SECO presso **Hall 1, Stand 320**.

SECO

SECO (IOT.MI) è un'azienda high-tech che sviluppa e realizza soluzioni all'avanguardia per la digitalizzazione di prodotti e processi industriali. L'offerta hardware e software di SECO abilita le realtà B2B ad introdurre edge computing, Internet of Things, data analytics ed intelligenza artificiale nei propri business. La tecnologia di SECO si estende a numerosi campi di applicazione: sono oltre 450 i clienti serviti in settori come il Medicale, l'Automazione Industriale, il Fitness, il Vending, il Trasportation e molti altri. Consentendo di monitorare in modo accurato l'operatività dei dispositivi on-field, le soluzioni SECO contribuiscono alla nascita di modelli di business a minor impatto ambientale grazie ad un più efficiente utilizzo delle risorse.

Per maggiori informazioni: <http://www.seco.com/>

Contatti

SECO S.p.A.

Clarence Nahan

Head of Corporate Development & Investor Relations

Tel. +39 0575 26979

investor.relations@seco.com

